

SMコンタクト

SM contact

SM-A364030A



- 材質 /Material ベリリウム銅 (t=0.1mm) Beryllium copper (t=0.1 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ =2.2 ~ 3.4mm Height: 2.2 mm to 3.4 mm

用途

Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

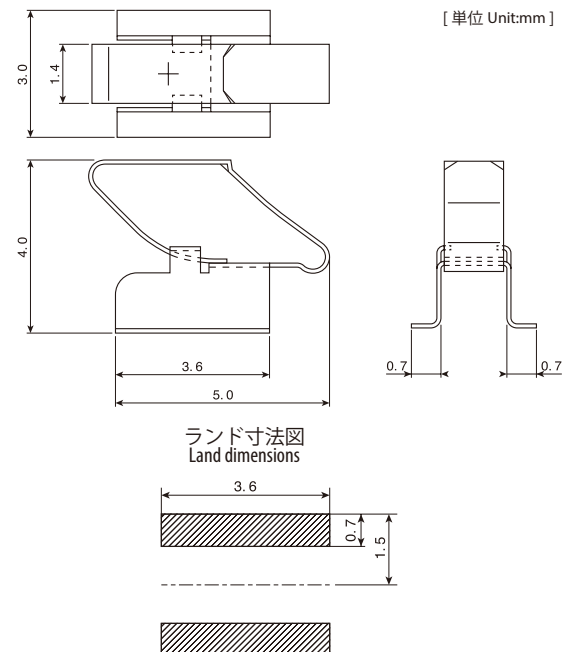
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

Standard packaging quantity

| 梱包形態 Packaging | 数量 Quantity | 備考 Remarks |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| テーピング Taping | 2,500ヶ (リール) 2,500/reel | 実数2,502ヶ (2ヶ予備) Actual quantity: 2,502 (two spares) |
| ダンボール Corrugated cardboard | 30,000ヶ (外箱) 30,000/box | 12リール/1箱 梱包 Twelve reels are packed in each box. |

* 外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



特性

Physical properties

| 試験項目 Test item | 性能・規格 Performance/specifications | 試験方法及び条件 |
|---|--|--|
| 初期抵抗値 Initial resistance | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 |
| 圧縮荷重 Compressive load | 2.6N以下 2.6 N or less | 測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mmに圧縮した時の反発力を測定する。 |
| 高温試験 High temperature test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr |
| 耐湿試験 Humidity test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 65℃/95% RH 処理時間: 500hr |
| 低温試験 Low temperature test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr |
| ヒートサイクル試験 Temperature cycle test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100 サイクル |
| 圧縮永久歪率測定 Compression set measurement | 25% 以下 25% or less | 製品を2.8mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー |
| 半田濡れ性試験 Solder wettability test | 浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder. | 半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)の IPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。 半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3 sec. |

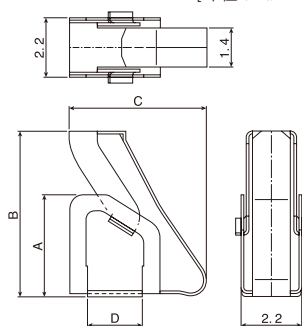
SMコンタクト
SM contact

SM-V series



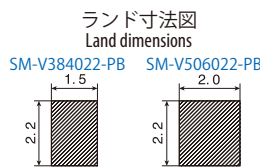
- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range SM-V384022-PB
高さ = 2.5 ~ 3.8mm Height: 2.5 mm to 3.8 mm
SM-V506022-PB
高さ = 3.7 ~ 5.8mm Height: 3.7 mm to 5.8 mm

[単位 Unit:mm]



用途 Applications

▶ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



品番表 Product list

| 品番 Product code | 寸法 [mm] Dimensions [mm] | | | | 標準梱包数量 Standard packaging quantity | |
|--------------------|----------------------------|-----|------|-----|--|---|
| | A | B | C | D | テーピング Taping | ダンボール Corrugated cardboard |
| SM-V384022-PB | 2.3 | 4.0 | 3.75 | 1.5 | 5,000ヶ (リール) /実数5,001ヶ(1ヶ予備) 5,000/reel; Actual quantity: 5,001 (one spare) | 60,000ヶ (外箱) 12リール/1箱 梱包 60,000/box (12 reels are packed in each box.) |
| SM-V506022-PB | 3.7 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 1,500ヶ (リール) 1,500/reel | 21,000ヶ (外箱) 14リール/1箱 梱包 21,000/box (14 reels are packed in each box.) |

特性 Physical properties

| 試験項目 Test item | 性能・規格 Performance/specifications | 試験方法及び条件 |
|---|--|---|
| 初期抵抗値 Initial resistance | 0.05Ω以下 0.05 Ω or less | 測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 |
| 圧縮荷重 Compressive load | 1.0N以下 (SM-V384022-PB) 1.0 N or less (SM-V384022-PB) 2.6N以下 (SM-V506022-PB) 2.6 N or less (SM-V506022-PB) | 測定用基盤に半田付けし、製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の反発力を測定する。 |
| 高温試験 High temperature test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：85℃ 処理時間：500hr |
| 耐湿試験 Humidity test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：65℃/95%RH 処理時間：500hr |
| 低温試験 Low temperature test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：-40℃ 処理時間：500hr |
| ヒートサイクル試験 Temperature cycle test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：-40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間：100 サイクル |
| 圧縮永久歪率測定 Compression set measurement | 30%以下 (SM-V384022-PB) 30% or less (SM-V384022-PB) 25%以下 (SM-V506022-PB) 25% or less (SM-V506022-PB) | 製品を2.8mm (SM-V384022-PB)、4.8mm(SM-V506022-PB)に圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度：-40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間：12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) x100 t0：初期高さ t1：処理後高さ t2：スパーサー |
| 半田濡れ性試験 Solder wettability test | 浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder. | 半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田：PF305 フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。半田温度：245±3℃ 浸漬時間：3 sec. |

SMコンタクト

SM contact

SM-485030-I



- 材 質 /Material..... リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze (t = 0.08 mm)
- メッキ処理 /Plating..... 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ =2.1 ~ 4.8mm Height: 2.1 mm to 4.8 mm

用途

Applications

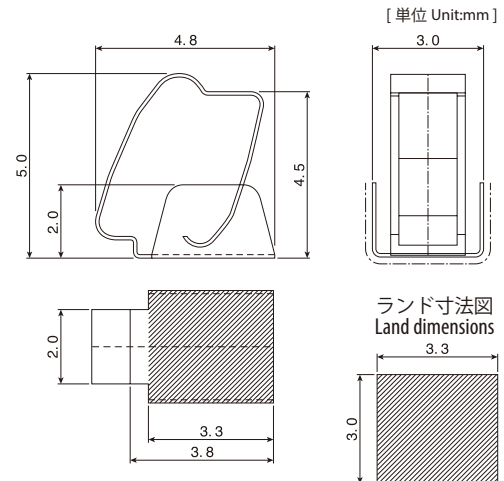
- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

Standard packaging quantity

| 梱包形態 Packaging | 数量 Quantity | 備考 Remarks |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| テーピング Taping | 2,000ヶ (リール) 2,000/reel | |
| ダンボール Corrugated cardboard | 28,000ヶ (外箱) 28,000/box | 14リール / 1箱 梱包 Fourteen reels are packed in each box. |

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



特性

Physical properties

| 試験項目 Test item | 性能・規格 Performance/specifications | 試験方法及び条件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---------|------|------|------|------|------|-------|---------|------|------|------|------|------|-------|
| 初期抵抗値 Initial resistance | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圧縮荷重 Compressive load | 0.5N ~ 1.2N 以下 0.5 N to 1.2 N | 測定用基盤に半田付けし、製品を4.7mm~2.7mmに圧縮した時の反発力を測定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 測定方法 製品を測定用基盤に半田付けし、製品高さを2.7mmに圧縮した時と4.7mmに圧縮した時の荷重をプッシュプルゲージを使用し手作業で測定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測定結果 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>サンプル1</th> <th>サンプル2</th> <th>サンプル3</th> <th>サンプル4</th> <th>サンプル5</th> <th>平均</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.7mm 時</td> <td>0.6N</td> <td>0.5N</td> <td>0.5N</td> <td>0.6N</td> <td>0.6N</td> <td>0.56N</td> </tr> <tr> <td>2.7mm 時</td> <td>1.2N</td> <td>1.1N</td> <td>1.1N</td> <td>1.2N</td> <td>1.1N</td> <td>1.14N</td> </tr> </tbody> </table> | | サンプル1 | サンプル2 | サンプル3 | サンプル4 | サンプル5 | 平均 | 4.7mm 時 | 0.6N | 0.5N | 0.5N | 0.6N | 0.6N | 0.56N | 2.7mm 時 | 1.2N | 1.1N | 1.1N | 1.2N | 1.1N | 1.14N |
| | サンプル1 | サンプル2 | サンプル3 | サンプル4 | サンプル5 | 平均 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7mm 時 | 0.6N | 0.5N | 0.5N | 0.6N | 0.6N | 0.56N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7mm 時 | 1.2N | 1.1N | 1.1N | 1.2N | 1.1N | 1.14N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高温試験 High temperature test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 耐湿試験 Humidity test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: 65℃/95% RH 処理時間: 500hr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 低温試験 Low temperature test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒートサイクル試験 Temperature cycle test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100 サイクル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圧縮永久歪率測定 Compression set measurement | 30% 以下 30% or less | 製品を4.7mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 12 サイクル 歪率(%)=(t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 半田濡れ性試験 Solder wettability test | 浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder. | 半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。 半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3 sec. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SMコンタクト

SM contact

SM-Z365325-PB



- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.15mm) Phosphor bronze (t = 0.15 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ = 3.4 ~ 5.0mm Height: 3.4 mm to 5.0 mm

用途

Applications

- ▶ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

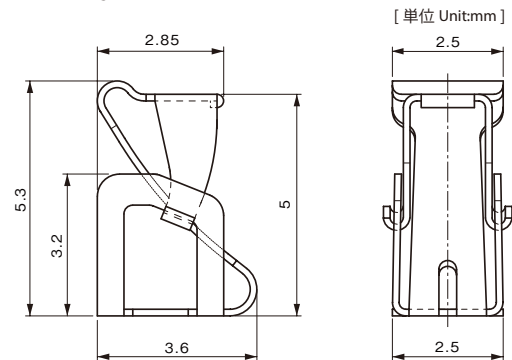
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

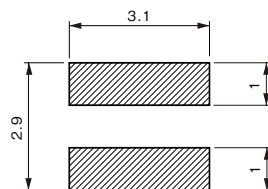
Standard packaging quantity

| 梱包形態 Packaging | 数量 Quantity | 備考 Remarks |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| テーピング Taping | 2,000ヶ (リール) 2,000/reel | |
| ダンボール Corrugated cardboard | 30,000ヶ (外箱) 30,000/box | 15リール/1箱 梱包 Fifteen reels are packed in each box. |

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



ランド寸法図
Land dimensions



特性

Physical properties

| 試験項目 Test item | 性能・規格 Performance/specifications | 試験方法及び条件 |
|---|--|--|
| 初期抵抗値 Initial resistance | 0.05Ω以下 0.05 Ω or less | 測定用基板上に半田付けし、製品を4.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 |
| 圧縮荷重 Compressive load | 5N以下 5 N or less | 測定用基板上に半田付けし、製品を4.0mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。 |
| 高温試験 High temperature test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：85℃ 処理時間：500hr |
| 耐湿試験 Humidity test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：60℃/95%RH 処理時間：500hr |
| 低温試験 Low temperature test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃ 処理時間：500hr |
| ヒートサイクル試験 Temperature cycle test | 0.05 Ω以下 0.05 Ω or less | 製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間：100サイクル |
| 圧縮永久歪率測定 Compression set measurement | 30%以下 30% or less | 製品を4.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。 処理温度：-40℃(3hr)~85℃(3hr) 処理時間：12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100 t0：初期高さ t1：処理後高さ t2：スパーサー |
| 半田濡れ性試験 Solder wettability test | 浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder. | 半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田：PF305 フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。 半田温度：245±3℃ 浸漬時間：3sec. |

SMコンタクト

SM contact

SM-D series



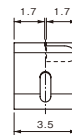
- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range SM-D733735-PB
高さ = 1.7 ~ 3.5mm Height: 1.7 mm to 3.5 mm
SM-D906039-PB
高さ = 3.5 ~ 5.8mm Height: 3.5 mm to 5.8 mm

用途

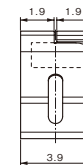
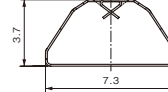
Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

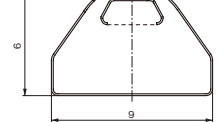
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.



SM-D733735-PB



[単位 Unit:mm]

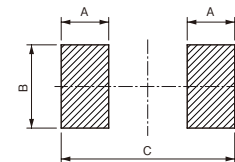


SM-D906039-PB

品番表

Product list

| 品番 Product code | 寸法[mm] Dimensions [mm] | | | 標準梱包数量 Standard packaging quantity | |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|---------------------------------------|--|
| | A | B | C | テーピング Taping | ダンボール Corrugated cardboard |
| SM-D733735-PB | 2 | 3.5 | 7.3 | 2,500ヶ (リール) 2,500/reel | 30,000ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 30,000/box (12 reels are packed in each box.) |
| SM-D906039-PB | 2 | 3.9 | 9.0 | 1,800ヶ (リール) 1,800/reel | 21,600ヶ (外箱) 12リール/1箱梱包 21,600/box (12 reels are packed in each box.) |

ランド寸法図
Land dimensions

特性

Physical properties

| 試験項目 Test item | 性能・規格 Performance/specifications | 試験方法及び条件 |
|---|--|--|
| 初期抵抗値 Initial resistance | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した時の抵抗値を測定する。 |
| 圧縮荷重 Compressive load | 5N以下 (SM-D733735-PB) 5 N or less (SM-D733735-PB) 2.2N以下 (SM-D906039-PB) 2.2 N or less (SM-D906039-PB) | 測定用基板上に半田付けし、製品を2.5mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。 測定用基板上に半田付けし、製品を4.2mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。 |
| 高温試験 High temperature test | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 85℃ 処理時間: 500hr |
| 耐湿試験 Humidity test | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: 60℃/95%RH 処理時間: 500hr |
| 低温試験 Low temperature test | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40℃ 処理時間: 500hr |
| ヒートサイクル試験 Temperature cycle test | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。処理温度: -40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間: 100サイクル |
| 圧縮永久歪率測定 Compression set measurement | 30%以下 30% or less | 製品を2.5mm (SM-D733735-PB)、4.2mm (SM-D906039-PB) に圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。処理温度: -40℃(3hr)~85℃(3hr) 処理時間: 12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー |
| 半田濡れ性試験 Solder wettability test | 浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder. | 半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。半田温度: 245±3℃ 浸漬時間: 3sec. (SM-D733735-PB)、5sec. (SM-D906039-PB) |

SMコンタクト

SM contact

SM-W353038-PB



- 材質 /Material リン青銅 (t=0.1mm) Phosphor bronze (t = 0.1 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ = 1.4 ~ 2.8mm Height: 1.4 mm to 2.8 mm

用途

Applications

- ▶ パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

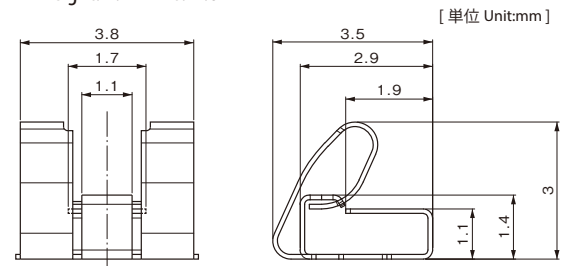
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

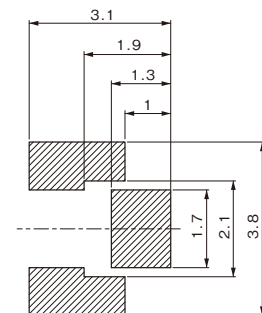
Standard packaging quantity

| 梱包形態 Packaging | 数量 Quantity | 備考 Remarks |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| テーピング Taping | 3,500ヶ (リール) 3,500/reel | |
| ダンボール Corrugated cardboard | 42,000ヶ (外箱) 42,000/box | 12リール/1箱 梱包 twelve reels are packed in each box. |

※外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



ランド寸法図
Land dimensions



特性

Physical properties

| 試験項目 Test item | 性能・規格 Performance/specifications | 試験方法及び条件 |
|---|--|--|
| 初期抵抗値 Initial resistance | 0.01Ω以下 0.01Ω or less | 測定用基板上に半田付けし、製品を2.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 |
| 圧縮荷重 Compressive load | 2.3N以下 2.3 N or less | 測定用基板上に半田付けし、製品を2.0mmに圧縮した時の圧縮力を測定する。 |
| 高温試験 High temperature test | 0.01 Ω以下 0.01 Ω or less | 製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：85℃ 処理時間：500hr |
| 耐湿試験 Humidity test | 0.01 Ω以下 0.01 Ω or less | 製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：60℃/95%RH 処理時間：500hr |
| 低温試験 Low temperature test | 0.01 Ω以下 0.01 Ω or less | 製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃ 処理時間：500hr |
| ヒートショック試験 Heat shock test | 0.01 Ω以下 0.01 Ω or less | 製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度：-40℃(1hr)~85℃(1hr) 処理時間：100サイクル |
| 圧縮永久歪率測定 Compression set measurement | 30%以下 30% or less | 製品を2.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後の歪率の測定を行なう。 処理温度：-40℃(3hr)~85℃(3hr) 処理時間：12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー |
| 半田濡れ性試験 Solder wettability test | 浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder. | 半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。 半田：PF305 フラックス：ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比率25%とする。 半田温度：245±3℃ 浸漬時間：3sec. |

SMコンタクト

SM contact

SM-E241512-PB



- 材 質 /Material リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze (t = 0.08 mm)
- メッキ処理 /Plating 全面: Niメッキ Whole surface: Ni plating
半田付部: Snメッキ Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range 高さ = 0.7 ~ 1.4mm Height: 0.7mm to 1.4mm

用途

Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

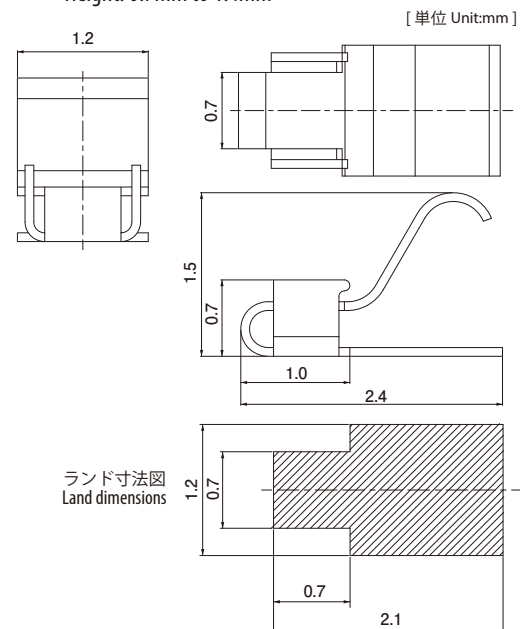
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

標準梱包数量

Standard packaging quantity

| 梱包形態 Packaging | 数量 Quantity | 備考 Remarks |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| テーピング Taping | 10,000ヶ(リール) 10,000/reel | |
| ダンボール Corrugated cardboard | 150,000ヶ(外箱) 150,000/box | 15リール / 1箱 梱包 Fifteen reels are packed in each box. |

* 外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。
* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



特性

Physical properties

| 試験項目 Test item | 性能・規格 Performance/specifications | 試験方法及び条件 |
|---|--|--|
| 初期抵抗値 Initial resistance | 0.1Ω以下 0.1Ω or less | 測定用基盤に半田付けし、製品を1.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。 |
| 圧縮荷重 Compressive load | 0.5N以下 0.5N or less | 測定用基盤に半田付けし、製品を1.0mmに圧縮した時の反発力を測定する。 |
| 高温試験 High temperature test | 0.1Ω以下 0.1Ω or less | 製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: 85°C 処理時間: 500hr |
| 耐湿試験 Humidity test | 0.1Ω以下 0.1Ω or less | 製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: 65°C/95% RH 処理時間: 500hr |
| 低温試験 Low temperature test | 0.1Ω以下 0.1Ω or less | 製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: -40°C 処理時間: 500hr |
| ヒートサイクル試験 Temperature cycle test | 0.1Ω以下 0.1Ω or less | 製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: -40°C(1hr)~85°C(1hr) 処理時間: 100サイクル |
| 圧縮永久歪率測定 Compression set measurement | 30%以下 30% or less | 製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: -40°C(3hr)~85°C(3hr) 処理時間: 12サイクル 歪率 (%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100 t0: 初期高さ t1: 処理後高さ t2: スペーサー |
| 半田濡れ性試験 Solder wettability test | 浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder. | 半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305 フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。半田温度: 245±3°C 浸漬時間: 5sec |